

Thermal Interface Material

Phase Change Material

Stanzteile nach Zeichnung

Pads stamped according to drawing

Geringer thermischer Widerstand

Very low thermal resistance

Stanzteile auf Rolle möglich

Roll material available

Träger
Carrier
P = Polyimide

DS-PC-B-1.6-P

DS-PC-B-1.6-P

Wärmeleitfähigkeit ¹ Thermal Conductivity ¹	W/mK	1.60
Dichte ² Density ²	g/cc	1.80
Einsatztemperatur Operation Temperature	°C	-40 / +150
Materialstärke Material Thickness	mm	0.100
Durchschlagsfestigkeit ³ Dielectric Breakdown Voltage ³	kV	5.0
Farbe Color	-	gelb / yellow
Härte ⁴ Hardness ⁴	Shore A	90

1 ASTM D5470 (modified) 2 Helium Pycnometer 3 ASTM D149 4 ASTM 2240

REV2018_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.